

# LG화학 2018년 상반기 석/박사 신입연구원 및 산학장학생 모집

※ 본 공고는 석/박사 지원자 대상이오니 학사 지원자는 학사 공고로 지원하여 주시기 바랍니다.

## 모집분야

소속	모집분야	근무지	관련전공
CTO	<b>중앙연구소</b> ▪ Platform Tech : 무기소재 합성/가공, 코팅, 분산, 점/접착, 유기/고분자 합성 및 물성, 박막증착, CFD, 고분자유변화, 공정설계, Optimization, 촉매, 분석, Printing & Patterning ▪ 친환경/Energy 소재 : 연료전지, 차세대 2차 전지 ▪ 고기능신소재 : 차세대 무기/고분자/전도성 소재, 친환경 소재(물, 공기 질 개선용 소재) ▪ 바이오 : 조직배양, 형질전환, 식물/작물 생리, 유전자편집, 실험통계, Machine Learning, 유전체분석(NGS), Protein Engineering, 분자육종	대전 서울 과천	화학/화학공학 고분자공학 금속/재료공학 기계/전기전자공학 생명/생명정보학 식물/작물생리학 유전체학/생화학
기초소재 사업본부	<b>기초소재연구소</b> ▪ 고부가가치 제품 개발 : 메탈로센촉매, 고효수성 수지, 합성고무, ABS 등 ▪ 고기능성 소재 개발 : 유/무기소재 합성/중합/가공 등 ▪ 공정 Modeling, Simulation & Optimization	대전 여수 과천 익산	화학/화학공학 고분자공학 금속/재료공학 기계공학
전지 사업본부	<b>Battery연구소</b> ▪ 소재/부품 개발 : 유/무기 소재 합성 및 분석 기술, 금속/고분자 재료 물성 연구 ▪ 전지 선행 개발 : 전기화학, 유/무기재료, 열/전기화학 반응 해석, 계면화학, 고분자 물성 ▪ 공정 선행 연구 : 유변학, 혼합/분산, 건조, 공정 제어, 검사 자동화, 정밀 압연, 금형 설계, 데이터 처리 ▪ Pack 개발 : 기계설계, CAE ▪ BMS : 회로/전장 부품, Safety 회로설계, Embedded/MBD SW 및 SoX/Machine Learning 알고리즘 연구개발 <b>소형전지개발센터</b> ▪ 선행기술 개발 : 고에너지밀도, 급속충전, 장수명 등의 신기술 개발 ▪ Cell 개발 : IT(휴대폰, 노트북), 자동차, Drone 등에 적용되는 이차전지 셀 설계 ▪ Pack 개발 1) 기구 : 사출/프레스설계, 구조 설계 및 용접 연구개발 및 검증 2) 회로 : H/W 및 S/W(알고리즘) 회로 설계 및 검증 <b>자동차전지개발센터</b> ▪ Cell 개발 : 전기 자동차용 리튬 이차전지 설계 및 양산 개발 ▪ Pack/Module 개발 : 자동차전지용 Pack 기구 및 부품 설계(CAD 활용) ▪ 전장부품 개발 : 자동차전지의 전장 부품 개발 ▪ BMS : 회로, 전장부품, Embedded SW, BMS System 개발 ▪ EMC 설계 : 자동차전지 EMC 디자인 최적화 설계 <b>ESS전지개발센터</b> ▪ Cell 개발(중대형 파우치) : 리튬 이차전지 설계 및 관련 소재, 소재 합성 및 전기화학 특성 분석 기술 ▪ Pack 개발 : 기구설계(사출/프레스), 구조/냉각 설계, 양산 설비 개발, 전력망 계통해석 ▪ 전장부품 개발 : ESS전지의 전장 부품 개발 ▪ BMS 회로/SW 개발 : HW/SW/FW 개발, 제어/신호처리, SOC 개발	대전 과천	화학/화학공학 고분자공학 금속/재료공학 기계공학 전기전자공학 컴퓨터공학
정보전자소재 사업본부	<b>정보전자소재연구소</b> ▪ Display 및 반도체 소재 : 유기 합성, 고분자 합성, 고분자 가공, 고분자 물성, 필름 가공, 표면처리, 점-점착 소재, 유/무기 Hybrid 소재, 광설계, 유변학 ▪ 수처리 필터 : 복합재료, 멤브레인, 고분자, 유/무기 Hybrid 소재, 미세유체공학 <b>사업부 제품개발</b> ▪ 광학소재(편광판), 고기능소재(Touch용 필름, 기능성 필름, 반도체소재), 수처리 필터 제품 개발	대전 청주 오창	화학/화학공학 고분자공학 재료공학 기계공학
재료 사업부	<b>재료연구소 / 사업부 제품개발</b> ▪ Display 소재 : Color / 투명 PR 용 광감성 재료 및 분산 기술 OLED물질 합성 및 소자 평가, 형광물질 개발 Polyimide 재료 및 Silicone 재료 개발 ▪ 전지 소재 : 전구체 / 양극재 합성 및 전지 재료 평가 ▪ 신규 분야 : 자동차 구조용 접착재료, 반도체 / 회로 소재, Bulk 세라믹 등 무기재료	대전 서울 청주 익산	화학/화학공학 무기화학 고분자공학 신소재/재료공학 기계/전기전자공학
생명과학 사업본부	<b>생명과학연구소</b> ▪ 신약탐색 : 당노, 면역항암 신약 및 신규백신 연구, 약효평가, 신규 타겟발굴, 기반기술 개발 ▪ 의약연구 : 독성/DMPK, 합성 및 바이오 의약 분석/평가 ▪ CMC : 바이오 배양/정제공정 개발, 합성공정 개발, 제형 개발 ▪ 임상 : 임상설계 및 관리, 의약품 허가/등록, 학술마케팅 등	서울 오송	생물학/미생물학 면역학/유전공학 화학/화학공학 고분자공학 약학/수의학 간호학 통계(임상)

## 지원자격

- 석사/박사 학위자 또는 2018년 8월 석사/박사 학위 취득 예정자
- 2019년 2월 이후 석/박사 취득 예정자의 경우 산학장학생 공고로 지원하여 주시기 바랍니다.
- 본 공고는 경력직 인정이 되지 않습니다. 경력 인정을 희망하시는 경우, 채용 홈페이지의 경력사원 모집(수시) 공고로 지원하여 주시기 바랍니다.
- ※ 박사학위 소지자 또는 경력 1년 이상의 석사학위 소지자는 경력 공고로 지원 가능
- 석박통합과정 진행중인 경우, 석사 신분으로 지원이 불가합니다.
- 해외여행에 결격사유가 없는 자, 남성의 경우 군필, 면제자 또는 전문연구요원 T/O 소지(보충역) 및 전직 가능자

## 전형일정

3/2 ~ 3/14	3월 말	4/7	4월 말-5월 초	5월 말	2018년 7월 1일
입사지원	서류전형	인적성검사 LG Way Fit Test - Job Competency Test	1차 면접 전공면접, 인성면접	2차 면접 임원면접	입사 및 산학장학생 지원 시작

※ 2014년 하반기부터 적성검사 유형에 인문역량(한자, 한국어)이 추가되었으나, 관련 내용은 <http://careers.lg.com>에서 확인하여 주시기 바랍니다.  
 ※ 전형은 국내에서만 진행이 되오니, 해외에 계신 분들은 참고하여 주시기 바랍니다.

## 지원방법

- 1) 서류접수 : LG그룹 채용사이트 (<http://careers.lg.com>) 내 LG화학 모집공고에서 On-line 지원
- 2) 제출서류 : 채용사이트 내 입사지원서, 전공요약 발표자료(PDF본)  
 ※ 연구분야 입력 시 공고에 첨부된 전공요약 발표자료를 표지 포함 5장 이내로 작성하여 PDF 파일로 업로드  
 - On-line 지원서 내 최종 학력 입력 시 논문/주요연구과제 항목에 업로드  
 - 지원서 접수 완료 이후, 전공요약 발표자료 수정 불가  
 - 본 파일은 전공면접 시 발표자료로 사용되므로 참고하셔서 작성해 주시기 바랍니다.  
 ※ 졸업(예정)증명서, 성적증명서, 공인어학성적표, 자격증 등은 면접 합격자에 한하여 제출 (추후 안내)
- 3) 접수기간 : 2018. 3. 2(금) ~ 3. 14(수) 최종 마감일은 오후 2시까지 지원 가능

## 기타사항

- 1) On-line 접수만 가능합니다. (우편, E-mail 및 방문 접수는 받지 않습니다.)  
 ※ 익스플로러 브라우저를 이용해주시기 바랍니다.
- 2) 허위기재 사실이 발견될 시에는 즉시 불합격 혹은 입사 취소가 됩니다.
- 3) 국가보훈대상자 및 장애인에 관한 법규에 의거 우대합니다.
- 4) 각 전형결과 및 통보는 E-mail로 진행되오니, E-mail주소를 정확하게 기재하여 주시기 바랍니다.
- 5) 기타 문의사항 발생 시  
 ① LG Careers Site 내 상단 "채용문의"에서 1:1 질문하기를 통해 문의  
 ② E-mail 및 비밀번호 분실 시 "로그인"에서 이메일주소 및 비밀번호 찾기를 통해 확인하여 주시기 바랍니다.  
 ③ LG화학 대전 인사지원팀(042-719-3778)으로 문의 (상담 가능 시간 : 평일 09-18시)  
 ※ 공고 마감일은 지원 관련 문의가 많아 답변 및 대응이 늦어질 수 있습니다. 등록 마감 이후, 추가 등록 및 수정이 불가하므로 등록관련 문의는 반드시 마감 3일 전까지 요청 완료하여 주시기 바랍니다.